

2023. 7. 25 新闻发布

“新进展” 本公司收到了用于三维封装以及扇出式封装工艺的晶圆处理系统设备的大量订单

艾美柯技术株式会社（AIMECHATEC, Ltd.，总部：日本茨城县龙崎市向阳台，社长：阿部猪佐雄），收到了巨头OSAT（Outsourced Semiconductor Assembly and Test）公司对晶圆处理系统设备的新订单，特此发布。

随着5G、物联网、人工智能和自动驾驶等市场的成长，三维封装（2.5D和3D）和扇出式（FANOUT）半导体封装的需求正在强劲发展，对进一步的减薄化和堆叠化的需求也在日益增加。

本公司的晶圆处理系统设备在减薄化和堆叠化的制程中承担着至关重要的工艺之一。我们通过将多年来致力于临时键合以及解键后清洗的工艺技术与本公司制造能力相结合，提供了高性能的晶圆处理系统设备。结果更多的巨头OSAT公司对本公司的设备给予了高度评价，从而收获了新的大批订单。目前我们也在收到众多半导体封装生产企业的大量咨询，由此可见广大客户正在考虑采用我们的设备，以实现提高良率的目标。

本公司依旧本着通过制程工艺上的不断创新，以达到创造更方便更丰富的生活方式，为社会做出更多的贡献而努力。

咨询：艾美柯技术株式会社

营业部 TEL：0297-62-9119

<https://www.ai-mech.com>